



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

CONSULTA PÚBLICA Nº 33 - SEI, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

A Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 32, de 15 de julho de 2019, torna pública a proposta de **alteração** do Processo Produtivo Básico – PPB de SISTEMA INTELIGENTE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (*INTELLIGENT STORAGE SYSTEM*).

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, no endereço:

<https://www.gov.br/produktividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/consultas-publicas-de-ppb-1/consultas-publicas-de-ppb-2022>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@economia.gov.br, cgct.ppb@mcti.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br.

GLENDIA BEZERRA LUSTOSA

Secretária de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços

ANEXO

PROPOSTA Nº 043/22 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA SISTEMA INTELIGENTE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (*INTELLIGENT STORAGE SYSTEM*), ESTABELECIDO PELAS PORTAIRAS INTERMINISTERIAIS SEPEC/ME/MCTIC Nº 43 E Nº 44 DE 30 DE AGOSTO DE 2019.

OBS.: A consulta está em forma de Portaria na versão da Lei de Informática, mas também vale para a versão da Zona Franca de Manaus, as alterações estão em desatque.

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto SISTEMA INTELIGENTE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (*INTELLIGENT STORAGE SYSTEM*), industrializado no País, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto no Anexo, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo 29 (vinte e nove) pontos por ano-calendário .

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo só será pontuado para o produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo deverá ser aplicado em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI.

§ 1º O investimento a que se refere o **caput** deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto incentivado no mercado interno, decorrente da comercialização, dos produtos a que se refere esta Portaria, nos termos dos §§1º e 2º do art. 9º do Decreto nº 10.356, de 20 de maio de 2020.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no **caput**, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizados até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se como SISTEMA INTELIGENTE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (*INTELLIGENT STORAGE SYSTEM*) o equipamento formado por gabinetes compostos por unidades individuais de armazenamento de dados, e que possua as seguintes características:

I - ter a função única e exclusiva de armazenar dados, de forma digital, em meio magnético; em meio magnético combinado com meio semicondutor; ou somente em meio semicondutor, tanto o gabinete principal como os possíveis gabinetes de expansão; e

II - ter como elemento de conexão física e lógica externa pelo menos uma unidade de processamento digital, contidos na NCM: 8471.50.

Art. 4º Para o processo de montagem e soldagem de todos os componentes em placa, quando pelo menos duas das funcionalidades citadas nas etapas VIII, IX e X do Anexo desta Portaria estiverem contidas em uma única placa, será permitida a soma da pontuação de cada etapa para efeito de atingimento da meta estabelecida no § 1º do art. 1º, desde que essa funcionalidade esteja integrada à placa em referência. (NR)

Art. 5º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Art. 6º Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC nº 43, de 30 de agosto de 2019.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

Etapa	Descrição da etapa produtiva	Pontos Totais
I	Projeto de desenvolvimento no País – Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	6

II	Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 2 pontos para cada 1% investido, limitado a um máximo de 10 pontos.	10
III	Desenvolvimento do <i>software</i> embarcado de baixo nível (<i>firmware</i>) da placa principal.	2
IV	Corte, dobra e furação ou outro processo de puncionamento, corte a laser ou estampagem das chapas metálicas da estrutura mecânica e das partes de fechamento do gabinete ou alojamento (gaveta) de discos, tais como portas, tetos, laterais e tampas.	5
V	Soldagem ou rebitagem das partes metálicas do gabinete ou alojamento (gaveta) de discos.	5
VI	Tratamento superficial e pintura das partes metálicas do gabinete ou alojamento (gaveta) de discos.	3
VII	Injeção, moldagem ou outro processo de conformação (impressão 3D) das partes plásticas do gabinete ou alojamento (gaveta de discos).	2
VIII	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de comunicação com a unidade controladora do disco.	7
IX	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de posicionamento da informação nos conjuntos de leitura e gravação.	2
X	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de leitura e gravação lógica da informação.	16
XI	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de conversor CA/CC.	2
XII	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa lógica da unidade de disco rígido e integração com o HDA.	20
XIII	Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM.	4
XIV	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de memória volátil do tipo RAM.	1
XV	Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do <i>Solid State Drive</i> e <i>on Board</i> (SSD).	29
XVI	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa do <i>Solid State Drive</i> (SSD).	4
XVII	Integração das placas de circuito impresso montadas e dos demais subconjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final.	5
XVIII	Formatação, configuração e testes finais.	1